

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

环旭电子股份有限公司

2026年6月29日投资者关系活动记录

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
时间	2026年6月29日
地点	线上会议
上市公司 参会人员	史金鹏（董事会秘书）、冯超（证券事务代表）
参会机构名称	华商基金、汇添富基金、国海富兰克林、易方达基金、嘉实基金、朱雀基金、申量基金、华创证券、华泰证券、中信证券、兴业证券、天风证券、花旗环球
投资者提问	<p style="text-align: center;">【简报环节】</p> <p>1、本次股东减持的具体情况</p> <p>公司控股股东本次拟通过大宗交易方案减持2%股本数，减持数量为47,778,700股，本次减持方式为大宗交易，6个月内大宗交易受让方不能减持其受让股份。</p> <p>大股东已超过10年未减持股份，且持股比例较高，对环旭电子的股票流通性会有一些影响，本次减持主要基于日月光投控在先进封装方面规划的高强度的资本性支出而形成的资金需求。为应对资金需求，除来自客户锁定产能的资金支持外，日月光投控需要增加渠道扩大资金的来源，以保证有充足的现金流支撑外部融资，保持合理的财务结构。同时，本次减持通过大宗交易的方式，受让方有6个月的限售期，也尽可能减少对二级市场的直接影响；此外，这次大宗交易也会通过国际知名投行撮合交易方式，选择看好公司长期发展的知名机构成为公司股东。</p> <p>2、公司的市值管理工作</p> <p>公司管理层也非常重视市值管理，在2019年-2026年期间已完成5次股票回购，累计回购</p>

5,200多万股，投入资金7.6亿元，每年现金分红比例都在30%以上。未来若公司股价面临较大市场压力，基于对公司长期发展充满信心的前提下，公司会进一步考虑通过股票回购来增强投资者对公司发展的信心。

在经营层面，从2018年中美贸易摩擦开始，坚持“模组化、多元化、全球化”的发展策略，稳健经营，通过国际化并购已完成全球化的业务布局。从中国大陆延伸到越南，中国台湾的产能也都逐步恢复起来了。在墨西哥、北非、波兰，公司都进行了一定程度的扩产。所以在未来全球化的制造和交付层面上，已经打下了比较好的基础。

2025年以来，公司明确AI相关业务发展方向，在端侧AI的SiP模组和AIDC相关的智能板卡、光通讯、服务器供电方面加快投资布局，智能眼镜的SiP模组、智能网卡今年都将贡献显著的业绩增量，光通讯板块的成都光创联、环旭电子的海防厂扩产投资下半年也将陆续投产，预期明年也将有显著的业绩增量。

3、光通信板块的情况

(1) 光模块

在光通讯板块，公司从2024年下半年开始寻找投资的标的，到2026年年初完成对成都光创联的并购。当下公司正在积极的在这个业务板块进行投资布局，在成都光创联，还有环旭电子海防厂的扩产投资，下半年也都将陆续投产，预期明年也将会有显著的业务增量。

目前来看，本轮AI浪潮在技术的发展和硬件的需求端非常迅猛，造成重要物料短缺和扩产设备交期大幅延长，服务北美头部客户需求，公司希望构建自动化程度较高的光模块产线，在产线设计和设备选型上，也花费了不少时间进行内部探讨和与供应商伙伴之间的磨合。

具体而言，在800G以及更高速率的产能的建设上，成都光创联的光引擎产能预估到8月末可以增加100K/M，规划到年底增加至200K/M，若订单及交付相对顺利的情况下，希望在2027年一季度进一步扩产至300K/M的产能。由于是新投资光引擎到光模块的产能，越南的投资进度会略慢于成都，第三季度能够完成100K/M光引擎产能的投资，第四季度完成100K/M光模块产能投资。公司将持续跟踪头部客户的需求预期，如果需求和排产预期相对明确，在明年上半年越南就可以扩产至200K/M的光模块产能。

由于光模块行业普遍面临物料短缺的问题，所以公司当下目标是以代工合作模式以更快速度实现量产。和头部厂商合作，可以利用其在物料资源上的优势，环旭提供产能投资和成本控制上更高的效率，协助头部厂商实现成本竞争力及争取市场份额。

(2) CPO

	<p>目前公司和ASE的研发中心积极对接，围绕CPO的相关应用，如D-FAU, ELSFP等加快布局。尤其是ELSFP，可以看到2027年的需求旺盛，光创联已经在不断优化迭代产品并看到了明确的机会，这部分可能有机会率先突破。未来公司也希望拓展交换机相关业务。</p> <p>4、创新业务与ASE的协同</p> <p>未来公司在创新业务的布局上，包括算力板卡、光通信、服务器供电等方面会持续与ASE一起在技术的垂直整合上有更紧密的合作，甚至围绕重点领域的大的产业投资机会上，也会加强协同。比如围绕一些行业核心标的的CVC投资上，环旭电子的CVC投资会有更多成果落地。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026年6月29日